

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年11月22日(2012.11.22)

【公開番号】特開2009-147089(P2009-147089A)

【公開日】平成21年7月2日(2009.7.2)

【年通号数】公開・登録公報2009-026

【出願番号】特願2007-322469(P2007-322469)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

H 0 5 K 13/04 (2006.01)

H 0 5 K 13/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/50 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 1 1 T

H 0 5 K 13/04 M

H 0 5 K 13/08 Q

H 0 1 L 21/50 F

【手続補正書】

【提出日】平成24年10月3日(2012.10.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

電子部品を粘着テープによって基板に実装する電子部品の実装装置であって、  
上記電子部品を保持する保持手段と、

上記保持手段に上記電子部品を受ける受け取りポジション、受け取りポジションで受けた電子部品に一方の面に離型テープが貼着されて所定長さに切断された粘着テープの他方の面を貼着して上記一方の面から上記離型テープを剥離する貼着剥離ポジション及び離型テープが剥離された粘着テープの一方の面によって上記電子部品を上記基板に実装する実装ポジションのそれぞれに上記電子部品を順次搬送位置決めする上記保持手段を有する搬送手段と、

上記実装ポジションに搬送された上記基板と、上記粘着テープが貼着された電子部品とを撮像する撮像手段と、

この撮像手段の撮像信号に基づいて所定長さに切断されて上記電子部品に貼着された上記粘着テープの上記電子部品に対するずれ量を算出する演算処理手段と、

この算出したずれ量に基づいて上記貼着剥離ポジションにおける上記電子部品と所定長さに切断された粘着テープとの相対的な位置決めを制御する制御手段と

を具備したことを特徴とする電子部品の実装装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

電子部品を粘着テープによって基板に実装する電子部品の実装方法であって、

上記電子部品を受ける受け取りポジション、この受け取りポジションで受けた電子部品

に一方の面に離型テープが貼着されて所定長さに切断された粘着テープの他方の面を貼着してから、上記一方の面から上記離型テープを剥離する貼着剥離ポジション及び上記離型テープが剥離された上記粘着テープの一方の面によって上記電子部品を上記基板に実装する実装ポジションのそれぞれに上記電子部品を順次搬送位置決めする工程と、

上記実装ポジションに搬送された上記基板と上記粘着テープが貼着された電子部品を撮像する工程と、

この撮像した撮像信号に基づいて所定長さに切断されて上記電子部品に貼着された上記粘着テープの上記電子部品に対するずれ量を算出する工程と、

この算出したずれ量に基づいて上記貼着剥離ポジションにおける上記電子部品と所定長さに切断された粘着テープの相対的な位置決めを制御する工程と

を具備したことを特徴とする電子部品の実装方法。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

この発明は、電子部品を粘着テープによって基板に実装する電子部品の実装装置であって、

上記電子部品を保持する保持手段と、

上記保持手段に上記電子部品を受ける受け取りポジション、受け取りポジションで受けた電子部品に一方の面に離型テープが貼着されて所定長さに切断された粘着テープの他方の面を貼着して上記一方の面から上記離型テープを剥離する貼着剥離ポジション及び離型テープが剥離された粘着テープの一方の面によって上記電子部品を上記基板に実装する実装ポジションのそれぞれに上記電子部品を順次搬送位置決めする上記保持手段を有する搬送手段と、

上記実装ポジションに搬送された上記基板と、上記粘着テープが貼着された電子部品とを撮像する撮像手段と、

この撮像手段の撮像信号に基づいて所定長さに切断されて上記電子部品に貼着された上記粘着テープの上記電子部品に対するずれ量を算出する演算処理手段と、

この算出したずれ量に基づいて上記貼着剥離ポジションにおける上記電子部品と所定長さに切断された粘着テープとの相対的な位置決めを制御する制御手段と

を具備したことを特徴とする電子部品の実装装置にある。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

この発明は、電子部品を粘着テープによって基板に実装する電子部品の実装方法であって、

上記電子部品を受ける受け取りポジション、この受け取りポジションで受けた電子部品に一方の面に離型テープが貼着されて所定長さに切断された粘着テープの他方の面を貼着してから、上記一方の面から上記離型テープを剥離する貼着剥離ポジション及び上記離型テープが剥離された上記粘着テープの一方の面によって上記電子部品を上記基板に実装する実装ポジションのそれぞれに上記電子部品を順次搬送位置決めする工程と、

上記実装ポジションに搬送された上記基板と上記粘着テープが貼着された電子部品を撮像する工程と、

この撮像した撮像信号に基づいて所定長さに切断されて上記電子部品に貼着された上記粘着テープの上記電子部品に対するずれ量を検出する工程と、

この算出したずれ量に基づいて上記貼着剥離ポジションにおける上記電子部品と所定長さに切断された粘着テープの相対的な位置決めを制御する工程とを具備したことを特徴とする電子部品の実装方法にある。